

Richtwerte/ Empfehlung „Trocknen von Leiterplatten vor Löten“

(Parametersetzung obliegt anwenderspezifischem Verarbeitungsprozess)

Zielstellung:

- **Trocknung = Verminderung Feuchtigkeit im Basismaterial vor Lötverfahren**
- **Vorbeugung Delamination durch thermische Beanspruchung nach Feuchteaufnahme**

Methoden:

- **Trocknung durch Konvektion bzw. in Vakuumtrockenofen**
- **Parameter* in Abhängigkeit von Materialtyp, Lötfläche, Lagenanzahl, Zeitspanne bis Löten, Layout (Cu-Flächen)**

Parameterempfehlung:

- **Trocknung in Konvektion-/ Umluftofen bzw. in Vakuumtrockenofen, nicht im Stapel**
- **Trocknung**

| Material | Parameter | Zeit bis Lötprozess |
|--|-------------------------|---------------------|
| FR4 (Tg 135 °C) | 120 °C, ≥ 120 min | maximal 24 h |
| FR4 (Tg > 135 °C) Starr-Flex, Flex, PI ML ≥ 6 Lg | 130 - 150 °C, ≥ 120 min | maximal 8 h |
- **Vakuumtrocknen bei 50 mbar erlaubt 20 K niedrigere Temp. und 60 Minuten kürzere Zeit**
- **Vakuumtrocknen bei thermisch sensiblen Oberflächen (z.B. chem. Zinn) empfohlen**

(siehe auch Richtwerte/ Empfehlung „Lagerbedingungen für unbestückte Leiterplatten“)